05.1;06.5;13.3

© М.А. Бунин, О.А. Бунина, Ю.А. Куприна, В.П. Завьялов

Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия E-mail: bunin.m.a@gmail.com

Поступило в Редакцию 14 мая 2019 г. В окончательной редакции 21 мая 2019 г. Принято к публикации 21 мая 2019 г.

Кристаллографические характеристики керамических образцов K_2 Sr₄Nb₁₀O₃₀ сопоставлены с данными о пьезоотклике поверхности, полученными методом сканирующей зондовой микроскопии, на основании которых оценены относительные величины пьезомодулей d_{33} . В зависимости от ориентации поверхности керамического образца относительно оси текстуры они в 62 или 58 раз превышают значение для изотропного образца. Причиной гигантского пьезоотклика поверхности могут быть анизотропные деформации решетки, вызванные действием давления при горячем прессовании. Обсуждается роль доменных границ и полярных нанообластей.

Ключевые слова: тетрагональная вольфрамовая бронза, пьезоотклик поверхности, текстура, K₂Sr₄Nb₁₀O₃₀.

DOI: 10.21883/PJTF.2019.16.48157.17876

Одноосные сегнетоэлектрики со структурой тетрагональной вольфрамовой бронзы (ТВБ) являются перспективной основой для бессвинцовых активных материалов нового поколения [1,2]. Технология горячего прессования (ГП) позволяет эффективно создавать в них аксиальную текстуру с преимущественной ориентацией осей с игольчатых кристаллитов перпендикулярно оси давления [3,4]. Ниобат калия-стронция K₂Sr₄Nb₁₀O₃₀ (KSN) со структурой ТВБ обладает высокими диэлектрическими, электромеханическими и электрооптическими характеристиками [5-8], которые обнаруживают зависимость от технологии получения [9]. Это может быть связано с различием микроструктуры получаемого вещества, а также с влиянием добавок, используемых при синтезе в расплаве солей, и испарением летучих компонентов в процессе синтеза. В технологии ГП эти факторы сведены к минимуму. В настоящей работе проведен сравнительный анализ структурных и микроструктурных характеристик керамики KSN, приготовленной с помощью метода ГП и обычной керамической технологии.

Полученный в результате ГП керамический блок характеризуется плотностью более 98% от теоретически возможного значения и степенью аксиальной текстуры 45%. Измерительные образцы KSN_N || Р и KSN_N \perp Р вырезались в двух различных ориентациях относительно оси текстуры (рис. 1). Контрольный изотропный образец KSN_*iso* получен с помощью обычной керамической технологии с использованием двухстадийного синтеза. Режимы синтеза и спекания керамики детально описаны в [9,10]. Рентгенодифракционные исследования выполнены на дифрактометре Rigaku UltimaIV, Cu K_{α} -излучение. Обнаруженные в горячепрессованной керамике остаточные деформации приводят к понижению температуры фазового перехода

на 25°С по сравнению с таковой для KSN_*iso*. Совместный анализ рентгенодифракционных данных двух измерительных образцов KSN_N || Р и KSN_N \perp Р позволил определить параметры тетрагональной решетки для *a*- и *c*-ориентированных кристаллитов (см. таблицу и рис. 2). Для образца KSN_N || Р отражения (*hk*0) формируются *a*-ориентированными кристаллитами, а отражения (00*l*) — *c*-ориентированными (рис. 2). Для образца KSN_N || Р отражения (*nk*0) формируются *a*-ориентированными кристаллитами, а отражения (00*l*) — *c*-ориентированными (рис. 2). Для образца KSN_N \perp Р отражения (*hk*0) формируются *c*-ориентированными кристаллитами, а отражения (00*l*) — *a*-ориентированными. Исходя из полученных значений параметров решетки определены относительные продольные деформации кристаллитов (см. таблицу): *a*-ориентированные кристаллитов (с



Рис. 1. Схема разрезки блока горячепрессованной керамики KSN. *Р* — ось давления горячего прессования (ось текстуры), *N* — направление нормали к рабочей плоскости измерительного образца.



Рис. 2. Параметры решетки и деформации *a*- и *c*-ориентированных кристаллитов. *P* — ось давления.

Параметры решетки и относительные продольные деформации кристаллитов в керамических измерительных образцах KSN (относительные продольные деформации рассчитаны как $\varepsilon_{11} = (a_t - a_{iso})/a_{iso}$, $\varepsilon_{33} = (c_t - c_{iso})/c_{iso}$; индексами *iso* и *t* обозначены параметры изотропного образца и текстурированной керамики)

| Тип кристаллитов | <i>a</i> , Å | <i>c</i> , Å | ε_{11} | E33 |
|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| KSN_iso | 12.448 | 3.931 | | |
| кристаллиты | 12.494 | 3.931 | 0.0037 | 0 |
| кристаллиты | 12.433 | 3.940 | -0.0012 | 0.0023 |

формации растяжения вдоль оси c и сжатия вдоль оси a без изменения объема, а c-ориентированные растянуты вдоль оси a с увеличением объема ячейки; их относительные продольные деформации ε_{33} увеличиваются с температурой и в области фазового перехода достигают максимальных значений.

Наличие текстуры, анизотропных деформаций кристаллитов и выявленные в [10] особенности структуры KSN должны сказаться на его объемных и поверхностных характеристиках, на пьезоотклике.

Значения объемного пьезомодуля d_{33} текстурированных образцов измерены на установке d33-METER YE2730A (APC Instruments) и составляют 59 pC/N для KSN_N || Р и 56 pC/N для KSN_N \perp Р. Неодинаковость значений объясняется нарушением изотропного распределения кристаллитов по ориентациям в текстурированных образцах. Кроме того, значительные величины деформаций ε_{11} для *с*-ориентированных кристаллитов (рис. 2) могут обусловливать относительно высокий вклад компоненты d_{31} в измеренное значение пьезомодуля.

Измерения пьезоотклика (PR) поверхности выполнены на сканирующем зондовом микроскопе (C3M) Veeco Multimode VS в контактном режиме по стандартной методике. Верхняя поверхность образца полировалась до зеркального блеска, в нижнюю вжигался серебряный электрод. Для повышения чувствительности применен мягкий зонд (SCM-PIC, $k \approx 0.2 \,\text{N/m}$, собственная частота 61.2 kHz). Из сравнения гистограмм рельефа на рис. 3, а видно, что характерные размеры деталей поверхности трех образцов различаются незначительно: 7-18 nm. При этом гистограммы PR (рис. 3, b и c) (так же как и соответствующие им изображения, не приведенные здесь ввиду краткого формата сообщения) отличаются от таковых для рельефа (рис. 3, a), зависимость амплитуды PR от амплитуды переменного напряжения Vac линейная, поэтому можно полагать, что изображения сформированы особенностями электромеханического отклика. Анализ частотной зависимости PR (аналогично [11]) показал, что при 50 kHz амплитуда пьезоотклика текстурированных образцов становится гигантской, для изотропного образца этого не наблюдается. Это хорошо видно из сравнения масштабов на гистограммах (рис. 3, b, c): отклик текстурированных образцов в 80-100 раз больше. Гистограммы PR (как и соответствующие им изображения) для KSN_N || Р и KSN_N \perp P (рис. 3, b и c) различаются из-за того, что их поверхности образуют по-разному ориентированные кристаллиты (рис. 2).

Поскольку амплитуда пьезоотклика прямо пропорциональна величине d₃₃ (вообще говоря, ее эффективному значению, но для оценки этого достаточно) [12], оценить изменения пьезоотклика удобно по отношениям величин пьезомодулей d_{33} , рассчитанных из амплитуд Dсмещений поверхности и напряжений Vac для текстурированных и изотропного образцов $(d_{33} = D/V_{ac} [13])$. Измерения выполнены с помощью одного и того же зонда, поэтому его чувствительность не влияет на результат. Для оценки D достаточно средних значений, взятых по верхнему максимуму гистограмм (рис. 3, b и c), а поскольку V_{ac} одинаковы для всех образцов (2400 mV), относительные пьезомодули d_{33} поверхности получаются как отношение значений D: 62 для KSN_N || Р и 58 для KSN_N⊥Р. Если полагать, что соотношение поверхностных пьезомодулей d_{33} такое же, как объемных, то на поверхности его значение $\sim 3 \cdot 10^3 \, \mathrm{pC/N}.$

Различия величин относительных пьезомодулей обусловлены характером текстурирования керамики и распределением электрического поля зонда в поверхностном слое. Кроме того, обнаруженные нами специфические анизотропные деформации кристаллитов KSN (см. таблицу) должны существенно влиять на межзеренный интерфейс. На нем [14,15] направление вектора спонтанной поляризации становится менее стабильным, а его чувствительность к внешнему полю повышается. В результате пьезоэлектрический отклик сильно увеличивается, причем его величина зависит от ориентации измерительного образца относительно оси текстуры, что соответствует различию относительных значений d_{33}



Рис. 3. Гистограммы распределения высот на C3M-сканах поверхности керамики $K_2Sr_4Nb_{10}O_{30}$. *а* — топография, *b* — пьезоотклик текстурированных образцов, *c* — пьезоотклик нетекстурированного образца. *I* — KSN_N || P, *2* — KSN_N \perp P, *3* — KSN_*iso*. По оси ординат указана относительная доля участков поверхности, имеющих соответствующую амплитуду пьезоотклика.

для KSN_N || Р и KSN_N \perp Р. В [16] описано похожее увеличение пьезомодуля (более чем в 10 раз) для нанокомпозитных мезокристаллитов BaTiO₃/Bi_{0.5}Na_{0.5}TiO₃ из-за разницы (2.6%) значений их постоянных решетки. В результате на гетероэпитаксиальной границе их раздела возникали деформации несогласования: решетка BaTiO₃ сжата, а Bi_{0.5}Na_{0.5}TiO₃ растянута. По-видимому, аналогичное влияние оказывают обнаруженные нами деформации *a*- и *c*-ориентированных кристаллитов в KSN.

Еще одной причиной сильного увеличения электромеханического отклика поверхности может быть высокая плотность доменных стенок [17]. Кристаллам KSN свойственна высокая плотность ненасыщенных доменных стенок [8]. Чтобы учесть влияние всех названных факторов, в том числе анизотропных механических напряжений и полярных нанообластей [10], на гигантский пьезоотклик в KSN, необходимо отдельное рассмотрение, возможно, в рамках уточненной модели [17].

Таким образом, впервые для сегнетоэлектрикарелаксора со структурой ТВБ обнаружен гигантский пьезоотклик поверхности, сходный по величине с наблюдавшимся ранее в перовскитах. Возможной причиной этого могут быть специфические для текстурированной керамики $K_2Sr_4Nb_{10}O_{30}$ анизотропные механические напряжения.

Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке проектной части государственного задания Минобрнауки РФ (тема № 3.1649.2017/4.6/ПЧ) и базовой части государственного задания Минобрнауки РФ (№ 3.6439.2017/БЧ).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] Tanaka S., Takahashi T., Furshima R., Makiya A., Uematsu K. // J. Ceram. Soc. Jpn. 2010. V. 118. P. 722–725.
- [2] Zhu X., Fu M., Stennett M.C., Vilarinho P.M., Levin I., Randall C.A., Gardner J., Morrison F.D., Reaney I.M. // Chem. Mater. 2015. V. 27. P. 3250–3261.
- [3] Ikeuchi Y., Takatsu H., Tassel C., Goto Y., Murakami T., Kageyama H. // Angew. Chem. Int. Ed. 2017. V. 56. P. 5770– 5773.
- [4] Филипьев В.С., Завьялов В.П., Бунина О.А., Гавриляченко С.В., Фесенко Е.Г. // ЖТФ. 1984. Т. 54. В. 3. С. 633–638.
- [5] Liu L, Gao F, Zhang Y, Sun H. // J. Alloys Compd. 2014.
 V. 616. P. 293–299.

- [6] Duran C., Yildiz A., Dursun S., Mackey J., Schirlioglu A. // Scripta Mater. 2016. V. 112. P. 114–117.
- [7] Neurgaonkar R.R., Ho W.W., Cory W.K., Hall W.F., Cross L.E. // Ferroelectrics. 1983. V. 51. P. 185–191.
- [8] Clarke R., Burfoot J.C. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1975. V. 8.
 P. 1115–1120.
- [9] Bunina O.A., Kuprina Yu.A., Raevski I.P., Knyazeva Ya.S., Raevskaya S.I., Chen H., Chou C.C., Titov V.V., Mezzane D., Sitalo E.I. // Ferroelectrics. 2016. V. 501. P. 145–153.
- [10] Bunin M.A., Bunina O.A., Kuprina Yu.A., Raevski I.P., Inozemtsev S.V., Chen H., Raevskaya S.I., Sitalo E.I. // Ferroelectrics. 2018. V. 525. P. 18–27.
- [11] Бунин М.А., Рыбянец А.Н., Федоровский А.Е., Сухомлинов Д.И., Бунина О.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2016. Т. 80. № 11. С. 1580–1582.
- [12] Proksch R., Kalinin S. Piezoresponse force microscopy with Asylum Research AFM's. Oxford Instruments Asylum Research, Inc., 2015. P. 1–21.
- [13] Hu D., Ma H., Tanaka Y., Zhao L., Feng Q. // Chem. Mater. 2015. V. 27. P. 4983–4994.
- [14] Jiang A., Scott J., Lu H., Chen Z. // J. Appl. Phys. 2003. V. 93.
 P. 1180–1185.
- [15] Johnston K., Huang X., Neaton J.B., Rabe K.M. // Phys. Rev. B. 2005. V. 71. P. 100103.
- [16] Zhang W., Ma H., Li S., Hu D., Kong X., Uemura S., Kusunose T., Feng Q. // Nanoscale. 2018. V. 10. P. 8196– 8206.
- [17] Sluka T., Tagantsev A., Damjanovic D., Gureev M., Setter N. // Nature Commun. 2012. V. 3. P. 748 (1–7).